**CEPC TDR电子学TDAQ会议记录**

时间：2024年6月13日9：00-9:45

参会人：

线下：常劲帆、严雄波、胡俊、魏微

线上：李飞、刘振安、章红宇、侯书云、赵京周、樊磊、张杰、李筱婷、赵梅、周启东、张颖、郭迪

记录：魏微

**会议纪要：**

1. 分系统讨论了当前进展和近期需要关注的问题

顶点探测器：

1. 芯片方面正在基于65nm PDK来评估像素单元尺寸。有些工艺层与180nm工艺不对应，需和foundry确认。目前可以优先以像素单元的面积评估为主，具体设计优化可以留待后续。
2. 机械部分及安装目前还有较大挑战，需进一步协同设计。

Outer tracker:

1. 近一两周以确定外边界为最优先目标。目前电子学方面尺寸基本已明确，主要是要向机械方面明确：散热应该贴近顶部初步看才比较有效率。需要结合热仿真的结果。
2. 可继续推动探测器输入参数的明确，包括cluster size等。明确之后，可进一步给出优化后功耗，再结合到电子学机械尺寸上，给出电子学全套接口参数。

量能器：

1. 本周探测器方面将会推动各个并行R&D方案提供电子学需求，但关键的还是每个方案的整体排布方案。前端方案或可兼容。
2. 有关刻度的方案还有较大不明确之处，需进一步跟进。
3. 长条晶体方案，电子学板目前较大可能只能按1cm宽度考虑。柔性板转弯半径也有限制，较大可能只能采用电缆焊接的方式实现相邻条的级联。但需关注晶体的机械固定方式，需明确电子学器件包括电缆均不能承力。